

■各製品と適合用途の関係

		一般用						コーティング・ポッティング用										耐熱用			放熱用								
		1成分				2成分		1成分						2成分				1成分			1成分		2成分						
		TSE 3221S	TSE 322	TSE 322S	TSE 322SX	TSE 3212	TSE 3320	TSE 3360	TSE 3250	TSE 325	TSE 325-B	TSE 3251	TSE 3251-C	TSE 3251H	TSE 3251H-C	TSE 3252	TSE 3253	TSE 3254	TSE 3033	TSE 3331	TSE 3330	TSE 326	TSE 326M	TSE 3260	TSE 3261-G	TSE 3280-G	TSE 3281-G	TSE 3380	
接 着	ハイブリッドICの基板とケースの接着	●	●	●	●	●	●																				●	●	●
シリコンゴム成形品の接着	シリコンゴム成形品の接着	●	●	●	●	●	●																						
接着(放熱用)	発熱体と放熱体の接着																									●	●	●	
シール	ハイブリッドIC、コンデンサーなど電子部品の防水・気密シール		●	●	●	●	●	●																					
シール(耐熱用)	アイロン、PTCのシール																					●	●	●	●				
固 定	各種回路部品の防振固定		●	●	●	●	●	●																					
ポッティング	ハイブリッドICなど各種電子部品のポッティング							●	●	●					●	●	●	●	●	●									
防湿コート	ハイブリッドIC、各種回路、基板の防湿コート	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
ディップコート	ハイブリッドIC、抵抗ネットワークなどのコーティング					●				●	●	●	●	●	●														
二次加工用原料	カラーインクなどのベースポリマー	●																											

※) ●: 好適